

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市募集资金投资项目及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

公司根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，拟定了本次募集资金拟建设投资项目。

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于：

序号	项目名称		拟投资总额 (万元)	利用募集资金投 资金额(万元)
1	12 英寸 半导体 硅片扩 产项目	年产 360 万片 12 英寸抛光 片生产线建设项目（二期）	290,000.00	174,000.00
		年产 240 万片 12 英寸抛光 片生产线建设项目	350,000.00	176,000.00
		小计	640,000.00	350,000.00
2	补充流动资金		100,000.00	100,000.00
合计			740,000.00	450,000.00

公司将严格按照募集资金管理制度的相关要求使用本次发行募集资金。若实际募集资金低于项目投资需求，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；若募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目建设实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次发行的实际募集资金超过上述项目投资需求，超出部分将用于补充公司营运资金或根据监管机构的有关规定使用。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届董事

会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事审计委员会第九次会议决议》
- 3、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
董事会

2026年2月13日